## 金安国纪集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号: 2025-002

用场景看,随着全球数字化进程加速,5G 通信基站建设进入规模化扩容阶段,万兆入户、5G-A/6G 移动通信持续推进,新一代通信技术对高频高速覆铜板的低损耗、高稳定性需求持续释放;新能源汽车渗透率稳步提升,车载电子系统(如智能驾驶芯片、电池管理系统等)的集成化发展推动了对高导热、高耐压覆铜板的需求增长;人工智能产业爆发式发展带动服务器、算力芯片等硬件设备迭代升级,高性能计算场景对覆铜板的电气性能与可靠性提出了更高标准。与此同时,消费电子领域虽经历短期波动,但可穿戴设备、AR/VR 终端等新兴品类的兴起逐步填补传统市场需求缺口,叠加消费电子行业的智能化、集成化结构性升级转型,增加了对高等级覆铜板需求,进一步拓宽了覆铜板的市场空间,覆铜板行业亟须加大研发投入力度、促进技术指标升级,才能满足下游行业的市场需求。我们顺应行业发展趋势,增强覆铜板行业在高端领域竞争力。

本次向特定对象发行的目的是优化产品结构,加速高端化转型,筑牢公司核心竞争力,同时公司产能利用率长期居高不下,产能瓶颈日益突出,为了突破产能瓶颈扩大公司生产规模,进一步完善市场布局,公司将在现有产品的基础上,积极研究新产品、新工艺和新技术,并紧贴行业发展趋势,在前沿技术领域上进一步探索,进一步提升公司整体的技术研发实力与创新能力,增强公司未来的发展潜力与市场竞争力。

## 2、此次募投中研发中心项目的研发背景和方向是什么?

答:近年来,国家、产业政策推动制造业高端化、智能化、绿色化发展,消费电子与AI 终端、新能源汽车、新能源与储能,通讯与数据中心、工业电子、工业机器人等终端行业领域快速发展,日新月异,并呈现多样化、集成化、智能化趋势,对覆铜板产品均提出了更高的标准要求,

如新一代通信技术对高频高速覆铜板的低损耗、高稳定性 要求:新能源汽车渗透率稳步提升,车载电子系统(如智 能驾驶芯片、电池管理系统等)的集成化发展推动了对高 导热、高耐压覆铜板的要求; 人工智能产业爆发式发展带 动服务器、算力芯片等硬件设备迭代升级,高性能计算场 景对覆铜板的电气性能与可靠性提出了更高标准。本次募 投的研发中心项目拟基于安徽宁国工厂现有研发设施基 础,增设先进研发及精密检测设备,并联动本地工厂高度 自动化、智能化的生产设施、构建高效的新产品性能验证 体系,显著提升研发迭代效率与技术成果转化能力。借鉴 上海公司市级企业研发中心建设经验,安徽宁国研发中心 将力争成为安徽省级企业研发中心。项目建设将基于现有 研发方向,持续强化公司在新产品、新工艺、新技术领域 的研究,同时面向行业发展方向,在前沿技术领域进行探 究,不断创新,支持高品质、高性价比、创新产品的产业 化落地, 形成自主知识产权, 构建行业技术壁垒, 减少对 中低端市场的依赖,从"成本竞争"转向"技术竞争", 提升长期盈利稳定性。

## 3、目前覆铜板行情怎么样?公司如何看待明年的覆铜板 行情走势?

答:随着电子行业新兴应用领域的蓬勃发展以及国家 大力扩大内需、提振消费,公司所处的覆铜板行业呈现出 高端市场需求旺盛,行业对高端市场投入进一步增加;传 统消费电子市场有所回暖,覆铜板价格总体略有回升、趋 势向好。

随着消费电子与 AI 终端、新能源汽车、新能源与储能,通讯与数据中心、工业电子、工业机器人等终端行业领域快速发展,新兴技术的兴起和新的应用场景的出现,带来了覆铜板市场新的需求,我们对覆铜板明年的市场行情持

	乐观态度。
	4、公司目前的产能多少?未来的扩产计划是怎样的?
	答:公司目前年产能约6000万张。未来计划:一是宁
	国项目剩余两条生产线(产能 1600 万张/年)预计将于明
	年七月投产; 二是本次向特定对象发行股票的新建项目,
	将新增 4000 万平米高等级覆铜板产能,以持续提升公司规
	模与市场竞争力。
	5、本次募投项目生产的高等级覆铜板主要应用于哪些领
	域?
	答:公司拟投资建设年产 4,000 万平方米高等级覆铜
	板项目,重点布局高频高速覆铜板、耐高温特种覆铜板、
	高 Tg 覆铜板及无卤无铅 FR-4 等高性能、特殊性能产品线,
	同步配置部分产能用于通用型 FR-4 覆铜板生产。
关于本次活动是否	
涉及应披露重大信 息的说明	否。
活动过程中所使用	
的演示文稿、提供 的文档等附件	无。